

2008年2月25日

半導体製造装置 1月のBBレシオ

～ 08年1月の日本・北米のBBレシオは依然1を下回る ～

アナリスト

中野 康三

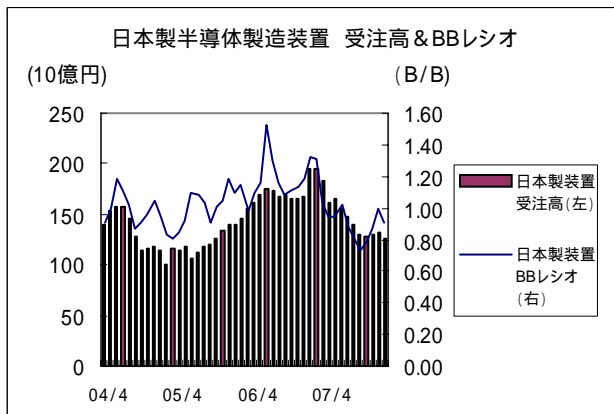
服部 隆生

(T.I.W.)

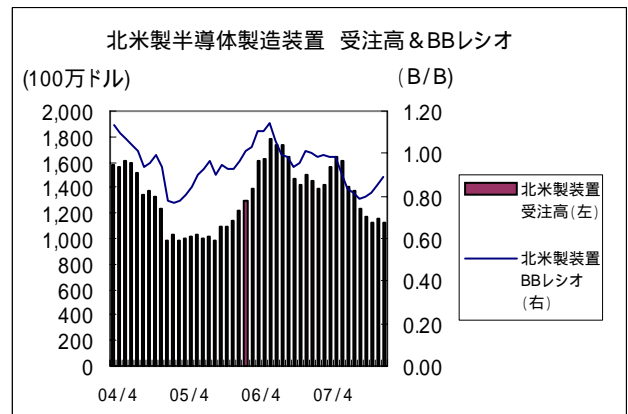
先日発表された08年1月の日本製SPE（半導体製造装置）の受注高（3カ月移動平均値）は、前月比4.4%減、前年同月比35%減で、BBレシオ*は07年12月の0.99から0.91へ0.08低下した。また、北米製のSPEについては、受注高が前月比3%減、前年同月比22%減、BBレシオは07年12月の0.85（前回速報では0.89）から0.89へ0.04上昇（SPE受注高、BBレシオとも1月は速報値）。

半導体製造装置メーカーの08/3期3Q（10-12月）の受注高は東京エレクトロン（8035）が前四半期比17%増、ディスコ（6146）が同6%増、アドバンテスト（6857）が同26%減となった。半導体メーカーのテストコスト削減の煽りを受けたと想定されるアドバンテストの不振が目立つ。DRAM価格については昨年来下落基調を歩んでいたが、メモリメーカーの生産調整による需給改善を受け足元では回復の兆しも見られる。とはいえ、新規アプリケーションの量産タイミングや半導体メーカーの設備投資の本格回復には依然不透明感が強く、09/3期も装置メーカーにとって予断を許さない状況が続きそうだ。

（*BBレシオ：Book to Bill Ratio、装置の販売額に対する受注額の割合。1を超えれば受注が強く、好調な状況を示す。）



(出所) SEAJ



(出所) SEMI

本レポートに掲載された情報・意見は株式会社ティー・アイ・ダヴリュが信頼にたると判断した情報源に基づき作成したものでありますが、完全性、正確性を保証するものではありません。本レポートに掲載された内容は必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は投資家ご自身の判断と責任で行って下さい。注意事項の詳細については最終ページをご参照ください。

アナリストによる宣言

私、中野康三、服部隆生は本調査レポートに表明された見解が、対象企業と証券に対する私個人の見解を正確に反映していることをここに証明します。また私は過去・現在・未来において、本レポートで特定の推奨を行うことに対して直接または間接に報酬を受けていないことを証明します。

利益相反に関する開示事項

株式会社ティー・アイ・ダヴリュ（以下、「T.I.W.社」）は、契約に基づき、アナリスト・レポートの提供を継続的に行うことに対する対価を契約先証券会社より包括的に得ておりますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企業の選定はT.I.W.社が独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三者からの指定は一切受けておりません。担当アナリスト並びにT.I.W.社と本レポートの対象会社との間には、利益相反の関係はありません。

本レポートに掲載された情報・意見は株式会社ティー・アイ・ダヴリュが信頼にたると判断した情報源に基づき作成したものでありますが、完全性、正確性を保証するものではありません。本レポートに掲載された内容は必ずしも適切且つ妥当なものとは限りません。投資に係る最終決定は投資家ご自身の判断と責任で行って下さい。注意事項の詳細については最終ページをご参照ください。

本レポートについて

1. 本レポートは、株式会社ティー・アイ・ダヴリュ(以下:弊社)が、投資家への情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。有価証券その他の取引等に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任で行って下さい。
2. 当資料に掲載されている内容の著作権は、原則として弊社に帰属いたします。本レポートにおいて提供される情報に関して、弊社の承諾を得ずに、当該情報の複製、販売、表示、配布、公表、修正、頒布または営利目的での利用を行う権利を有しません。
3. 本レポートは、弊社が信頼できると判断した情報源に基づき記載されたものですが、その正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、本レポートに記載された見解や予測は、本レポート発行時における弊社の判断であり、予告なしに変更されることがあります。
4. 本レポートにおいて提供されるいかなる情報もしくは分析に、またはそれらの正確性、完全性もしくは適時性に、投資家が依拠した結果として被る可能性のある直接的、間接的、付随的もしくは特別な損害またはその他の損害について、弊社が責任を負うものではありませんのでご了承ください。